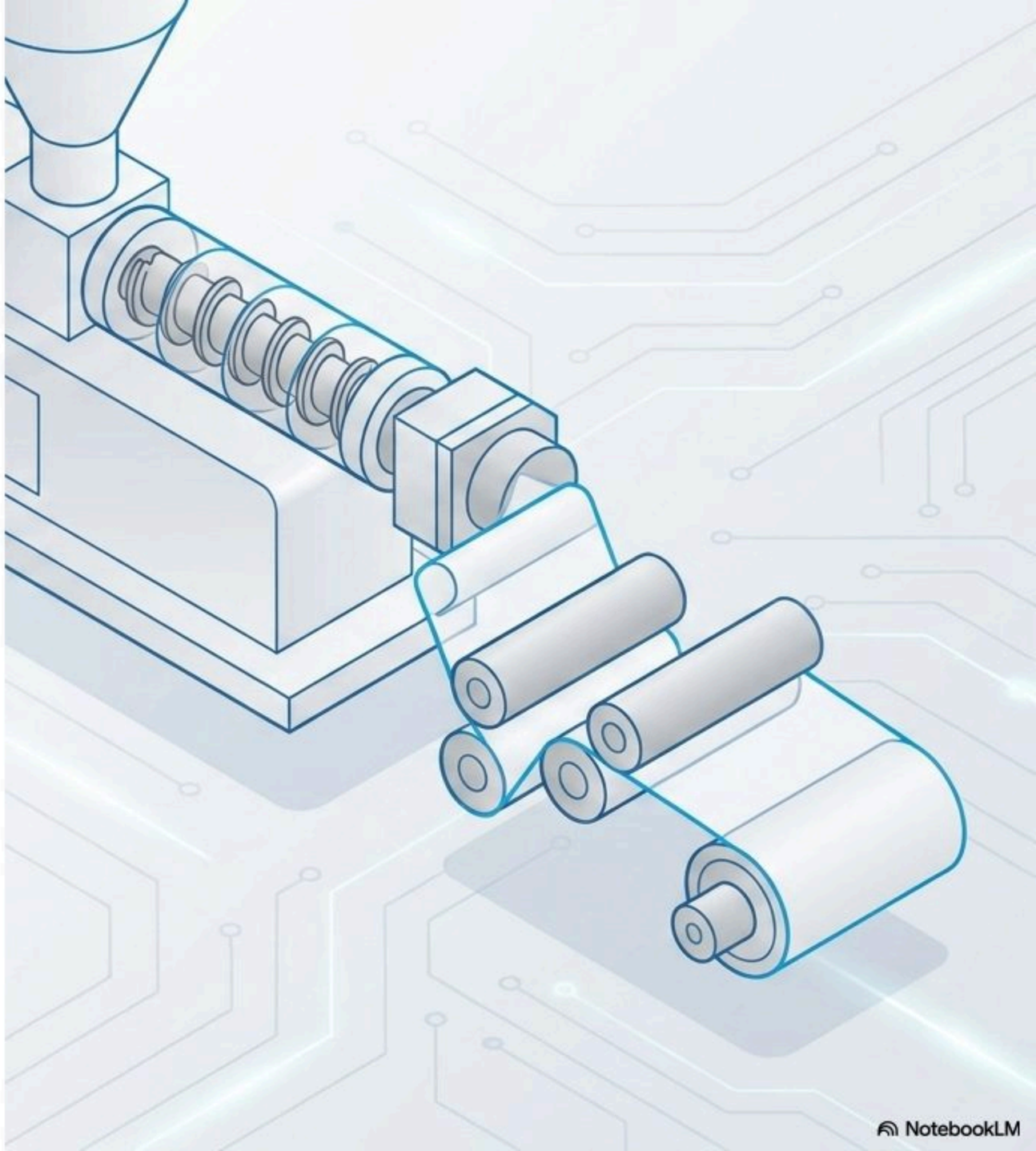
SABIC® PP 620P

PP Random Kopolimer

Levha Ekstrüzyonu (Sheet Extrusion)

Dengeli mekanik özellikler ve kolay işlenebilirlik sunan genel amaçlı ekstrüzyon çözümü.

سابک
sabic



NotebookLM

Teknik Özet

1.7 g/10 min

MFR (230 °C, 2.16 kg)

905 kg/m³

ASTM D 792

200 J/m

Izod Çentikli (23 °C)

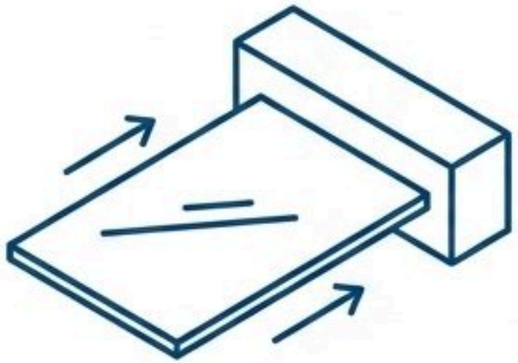
128 °C

Vicat Yumuşama (10 N)

Geniş moleküler ağırlık dağılımı (Broad MWD) ve orta seviye izotaktik yapı.

NotebookLM

Kullanım Alanları



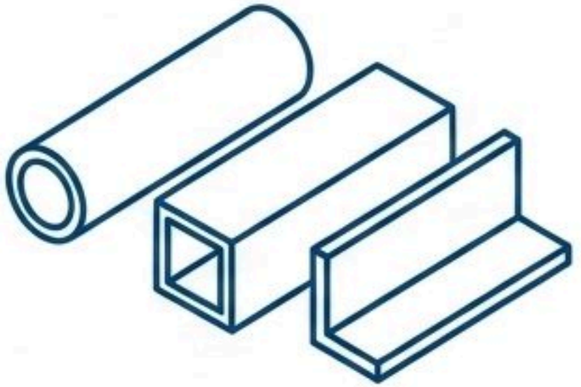
Levha Ekstrüzyonu (Sheet Extrusion)

Ana üretim amacı. Mükemmel form tutma ve güvenilir çekme performansı.



Şişirme Kalıplama (Blow Moulding)

Düşük akışkanlık değerinin (MFR 1.7) sağladığı avantajla stabil şekillendirme.



Genel Ekstrüzyon Uygulamaları

Temel kimyasal tasarımı sayesinde çeşitli kesit ve profil ihtiyaçlarına esnek uyum.

Geniş moleküler ağırlık dağılımı (Broad MWD) ve orta seviye izotaktik yapı.

NotebookLM



Neden Seçilir?

1

Dengeli Performans

950 MPa sekant modülü ve 26 MPa akma mukavemeti ile yapısal bütünlük ve esneklik arasında ideal denge.

2

Kolay İşlenebilirlik

Özel formülü (basic design) sayesinde karmaşık olmayan, sorunsuz bir ekstrüzyon akış davranışı.

3

Geniş Üretim Yelpazesi

Genel amaçlı yapısı sayesinde tek stok kalemiyle birden fazla ekstrüzyon hattını besleme imkanı.

NotebookLM



Ne Zaman Seçilmez?

1 Yüksek Akışkanlık Beklenen Prosesler

MFR değeri 1.7’dir; hızlı dolum gerektiren enjeksiyon kalıplama gibi yüksek akış (high-flow) istenen prosesler için tasarlanmamıştır.

2 Dar Moleküler Dağılım İhtiyacı

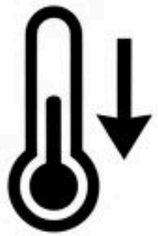
Spesifik özellikler gerektiren dar dağılımların aksine, bu ürün genel amaçlı geniş moleküler ağırlık dağılımına (Broad MWD) sahiptir.

3 Aşırı Yüksek Sıcaklık Uygulamaları

50 N yük altında Vicat yumuşama noktası 63 °C’dir; malzemenin aşırı ısıl dirence maruz kalacağı nihai ürünlerde tercih edilmemelidir.

NotebookLM

Proses ve Depolama Uyarıları



<50 °C

Malzemeyi uzun süreli yüksek sıcaklıklardan kesinlikle koruyun.



Açık Ortam Riskleri

Direkt güneş ışığına ve yüksek neme maruz bırakmayın; malzemenin ve ambalajın kalitesinde hızlı bozulmalar yaşanabilir.



%100 Kuru Depolama

Sorunsuz bir işleme (processing) performansı elde etmek için malzemenin prosese girene kadar tamamen kuru kalmasını sağlayın.

NotebookLM

Karar Özeti

Ekstrüzyon, levha çekme veya şişirme kalıplama prosesleriniz için güvenilir, mekanik dengesi yüksek ve kolay işlenebilen genel amaçlı bir PP Random Kopolimer arıyorsanız; SABIC® PP 620P en ideal başlangıç noktasıdır.

ISO9001 sertifikalı uluslararası üretim standartları (SABIC Europe)

MSDS ve Ürün Güvenlik Beyanları İçin → sabic-europe.com

NotebookLM